

Compression Molding System

LCM1010-A



**Automatic compression molding system
for mass production of LED packages**

用于大规模生产LED封装的自动压缩成形设备

产品信息



中文

- 通过液体点胶来实现硅树脂的自动上料
- 通过压缩成形方式提高了树脂使用效率
- 实现均一稳定的透镜形状及高精度的成形品
- 可通过增设或减少模组的方式灵活应对产能变化



SPECIFICATION

Items		Unit	Description			
机型		—	LCM1010-A			
框架·基板类型		—	基板·引线框架			
框架·基板尺寸		mm	1 strip: 70—150(W)×70—150(L) 2 strip: 45—70(W)×50—150(L)			
树脂		—	液态			
机械时间		sec	37			
外形尺寸	模组数量	module	1	2	3	4
	宽度	mm	2,550	3,190	3,830	4,470
	纵深	mm	1,400	1,400	1,400	1,400
	高度	mm	1,700	1,700	1,700	1,700
重量		ton	3.6	5.4	7.2	9.0
每模成形框架数量		workpiece	2	4	6	8
料盒放置空间		mm	300			
合模压力		kN／(tf)	29.4—98.0／3.0—10.0			
合模速度		mm／sec	52 (Max.)			
品种切换方式		—	采用KIT更换方式			
使用分离膜的宽度		mm	1 strip: 210 (Max.) 2 strip: 110 (Max.)			
吐胶器类型	预混合	—	○			
	两液型	—	○			

- 以上数据为本公司标准机型时的规格
- 以上规格根据实际需要有改良变更的可能
- 如有其他特殊规格要求，另行协商
- 外形尺寸是采用预混型分配器时的尺寸



东和半导体设备（上海）有限公司
中国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A
TEL 021-6888-6860

Website



Inquiry contact



TOWA（本公司商标），是TOWA株式会社的商标或注册商标。

Overseas Sales Contacts

Japan/Headquarters

TOWA Corporation

China

TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
TOWA Taiwan Co., Ltd.

Korea

TOWA Korea Co., Ltd.

Singapore

TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

Malaysia

TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

Philippines

TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp.

Thailand

TOWA THAI COMPANY LIMITED

India

TOWA SEMICONDUCTOR INDIA
PRIVATE LIMITED

Germany

TOWA Europe GmbH

Netherlands

TOWA Europe B.V.

the United States

TOWA USA Corporation

20250401-004-HQ